

【1. 適用範囲 SCOPE】

本仕様書は、\_\_\_\_\_ 殿 に納入する  
 1.2mm ピッチ SMT基板用コネクタ \_\_\_\_\_ について規定する。  
 This specification covers the 1.20mm Pitch, W-T-B CONNECTOR series.

【2. 製品名称及び型番 PRODUCT NAME AND PART NUMBER】

製品名称 Product Name	製品型番 Part Number
リセ ターミナル Receptacle Terminal	7 8 1 7 2 0 4 * *
リセ ハウジング 2~5極 Receptacle Housing 2 ~ 5 ckt	7 8 1 7 2 0 0 0 *
プラグ アセンブリ エンボス梱包品 2~5極 Embossed tape packaging of Plug Assembly 2~5ckt	7 8 1 7 1 0 0 0 *

REV.	B								
SHEET	1-16								
REVISE ON PC ONLY					TITLE: 1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR 製品仕様書				
<b>B</b>	変更 REVISED J2016-0360 '15/10/20 T.AKAIKE				THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
REV.	DESCRIPTION								
DESIGN CONTROL J			STATUS		WRITTEN BY: CWLAM	CHECKED BY: LS LEE	APPROVED BY: NUKITA	DATE: YR/MO/DAY 2010/12/07	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-78171-010</b>								FILE NAME PS-78171-010.docx	SHEET 1 OF 16
EN-037(2015-09 rev.4)									

【3. 定格及び適用電線 RATINGS AND APPLICABLE WIRES】

項目 Item	規格 Standard		
最大許容電圧 Allowable Voltage (MAX.)	50 V		[ AC (実効値 rms) / DC ]
最大許容電流 及び 適用電線 Allowable Current ( MAX. ) And Applicable wires	AWG#28	1.5A	被覆外径 : φ0.6~φ0.7mm Insulation O.D.
	AWG#30	1.0A	
使用温度範囲 <sup>*1*2*3</sup> Ambient Temperature Range	-25°C ~ +85°C 低温において氷結しないこと Not freeze in low temperature		

- \*1 : 基板実装後の無通電状態は、使用温度範囲が適用されます。  
Non-operating connectors after reflow must follow the operating temperature range condition.
- \*2 : 通電による温度上昇分を含む。  
This includes the terminal temperature rise generated by conducting electricity.
- \*3 : 適合電線も本使用温度範囲を満足すること。  
Applicable wires must also meet the specified temperature range.

<b>B</b>	REVISE ON PC ONLY	TITLE: 1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR 製品仕様書
	SEE SHEET 1 OF 16	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER <b>PS-78171-010</b>		FILE NAME PS-78171-010.docx
		SHEET 2 OF 16
EN-037(2015-09 rev.4)		

**【4. 性能 PERFORMANCE】**

4-1. 電氣的性能 Electrical performance

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-1-1	接 触 抵 抗 Contact Resistance	コネクタを嵌合させ、開放電圧 20mV以下、短絡電流 10mA にて測定する。(EIA-364-23)  Mate connectors and measured by dry circuit, 20mV MAX., 10mA. (EIA-364-23)	20 milliohms MAX.
4-1-2	絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、DC 500Vを印加し測定する。(EIA-364-21)  Mate connectors and apply 500V DC between adjacent terminal or ground. (EIA-364-21)	100 Megohms MIN.
4-1-3	耐 電 圧 Dielectric Withstanding Voltage	コネクタを嵌合させ、隣接するターミナル間及びターミナル、アース間に、AC 500V (実効値) を1分間 印加する。(EIA-364-20)  Mate connectors and apply 500V AC(rms) for 1 minute between adjacent terminal or ground. (EIA-364-20)	異状なきこと No Breakdown

REVISE ON PC ONLY

**B**

SEE SHEET 1 OF 16

TITLE:

1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER

**PS-78171-010**

FILE NAME

PS-78171-010.docx

SHEET

3 OF 16

4-2. 機械的性能 Mechanical Performance

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement
4-2-1	挿入力及び抜去力 Insertion and Withdrawal Force	毎分25±3mmの速さで挿入、抜去を <u>垂直</u> に行う。 (EIA-364-13) Insert and withdraw connectors <b>vertically</b> at the speed rate of 25±3mm/minute. (EIA-364-13)	第6項参照 Refer to paragraph 6
4-2-2	圧着部引張強度 Crimping Pull out Force	圧着されたターミナルを治具に固定し、電線を軸方 向に毎分12.7mmの速さで引張る。 Fix the crimped terminal to the jig, apply axial pull out force on the wire at the speed rate of 12.7 mm/minute.	CS-78172-013にを満 たすこと Refer to Crimp Specification CS-78172-013
4-2-3	HDR端子保持力 Header Terminal Retention Force	ハウジングに装着されたターミナルを 毎分 12.7mm の速さで軸方向に引張る。 Apply axial pull out force at the speed rate of 12.7mm/minute on the terminal assembled in the housing.	4N {0.40 kgf} MIN.

REVISE ON PC ONLY

**B**

SEE SHEET 1 OF 16

TITLE:

1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO  
MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER  
**PS-78171-010**

FILE NAME

PS-78171-010.docx

SHEET

4 OF 16

4-3. 環境性能、その他 Environmental Performance and Others

項目 Item		条件 Test Condition	規格 Requirement	
4-3-1	繰り返し挿抜 Repeated Insertion / Withdrawal	1分間 10回 以下の速さで、挿入、抜去を10回 繰返す。 (EIA-364-09) Mate and un-mate 10 cycles repeatedly by rate of less than 10 cycles per minute. (EIA-364-09)	接触抵抗 Contact Resistance	20 milliohms MAX.
4-3-2	温度上昇 Temperature Rise	コネクタを嵌合させ、全ての圧着端子を直列に接続し最大許容電圧/電流を2時間印加した後の温度上昇を熱電対で測定する。 (但し、抵抗負荷) (EIA-364-70) Mate connectors and all crimp terminals shall be connected in a direct series. The temperature rise shall be measured after 2 hours when the terminal reaches terminal equilibrium under allowable voltage / allowable current. (However with resistive load) (EIA-364-70)	温度上昇 Temperature Rise	30 °C MAX.
4-3-3	耐振動性 Vibration	コネクタを嵌合させ、DC 1mA 通電状態にて、嵌合軸を含む互いに垂直な 3方向に 掃引割合 10~55~10 Hz/分、全振幅 1.52mm の振動を各2時間 加える。(ケーブルは固定すること) (EIA-364-28)  Mate connectors and subject to the following vibration conditions, for a period of 2 hours in each of 3 mutually perpendicular axes, passing DC 1mA during the test. (Fix the cable at test.) Amplitude : 1.52mm P-P Frequency : 10~55~10 Hz in 1 minute. Duration : 2 hours in each X.Y.Z.axes. (EIA-364-28)	接触抵抗 Contact Resistance	20 milliohms MAX.
			瞬断 Discontinuity	1 micro second MAX.

REVISE ON PC ONLY

**B**

SEE SHEET 1 OF 16

TITLE:

1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR

製品仕様書

REV.

DESCRIPTION

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

DOCUMENT NUMBER  
**PS-78171-010**

FILE NAME

PS-78171-010.docx

SHEET

5 OF 16

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-4	耐熱性 Heat Resistance	コネクタを嵌合させ、85±2°C の雰囲気中に96時間放置後取り出し、1～2時間室温に放置する。 (EIA-364-32) Mate connectors and expose to 85±2°C for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours , after which the specified measurements shall be performed. (EIA-364-32)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	20 milliohms MAX
4-3-5	耐湿性 Humidity	コネクタを嵌合させ、40±2°C、相対湿度90～95% の雰囲気中に 96時間 放置後取り出し、1～2時間 室温に放置する。 (EIA-364-31)  Mate connectors and expose to 40±2°C, relative humidity 90 to 95% for 96 hours. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. (EIA-364-31)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	20 milliohms MAX.
			絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	4-1-2項満足のこと Must meet 4-1-2
			耐 電 圧 Dielectric Strength	4-1-3項満足のこと Must meet 4-1-3

REVISE ON PC ONLY

**B**

SEE SHEET 1 OF 16

TITLE:

1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR

製品仕様書

THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

REV.

DESCRIPTION

DOCUMENT NUMBER  
**PS-78171-010**

FILE NAME

PS-78171-010.docx

SHEET

6 OF 16

項 目 Item		条 件 Test Condition	規 格 Requirement	
4-3-6	温度サイクル Temperature Cycling	コネクタを嵌合させ、 $-25\pm 3^{\circ}\text{C}$ に 30分、 $+85\pm 2^{\circ}\text{C}$ に 30分。これを1サイクルとし、5サイクル 繰返す。 但し、温度移行時間は 5分以内 とする。 試験後1~2時間 室温に放置する。 (EIA-364-32)  Mate connectors and subject to the following conditions for 5 cycles. Upon completion of the exposure period, the test specimens shall be conditioned at ambient room conditions for 1 to 2 hours, after which the specified measurements shall be performed. 5 cycles of : a) $-25\pm 3^{\circ}\text{C}$ 30 minutes b) $+85\pm 2^{\circ}\text{C}$ 30 minutes (EIA-364-32)	外 観 Appearance	異常なきこと No Damage
			絶 縁 抵 抗 Insulation Resistance	100 Megohms MIN.
			接 触 抵 抗 Contact Resistance	20 milliohms MAX. (Change from initial)
			耐 電 圧 Dielectric Withstanding Voltage	異常なきこと No Breakdown
4-3-7	半田付け性 Solderability	EIA-638に従った評価を実施する。 Parts shall be tested as per EIS-638.	濡れ性 Solder Wetting	ピンホールや 隙間なく浸漬面積 の95%以上 (SMES-152) 95% of immersed area must show no voids, pin holes. (SMES-152)
4-3-8	半田耐熱性 Resistance to Soldering Heat	<u>大気リフロー時</u> (Reflow by Air Reflow Machine) Average Ramp Rate $3^{\circ}\text{C}/\text{sec}$ max. Preheat Temp. (Min.) $150^{\circ}\text{C}$ Preheat Temp. (Max.) $200^{\circ}\text{C}$ Preheat Time      60 – 180sec Ramp to Peak $3^{\circ}\text{C}/\text{sec}$ max. Time over liquidus      60 – 150 sec Peak Temperature $260 +0/-5^{\circ}\text{C}$ Time within $5^{\circ}\text{C}$ of peak      10 – 15 sec. Ramp – Cool Down $6^{\circ}\text{C}/\text{sec}$ max. Time $25^{\circ}\text{C}$ to Peak      8 mins max	外 観 Appearance	端子ガタ、割れ等 異常なきこと No Damage

( ): 参考規格      Reference Standard  
{ }: 参考単位      Reference Unit

REVISE ON PC ONLY		TITLE: <b>1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR</b> 製品仕様書
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 16	
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER <b>PS-78171-010</b>		FILE NAME PS-78171-010.docx
		SHEET 7 OF 16

【5. 外観形状、寸法及び材質 PRODUCT SHAPE, DIMENSIONS AND MATERIALS】

5-1. 製品寸法及び材質 Dimensions and materials of product.

図面参照 Refer to the drawing.

【6. 梱包 PACKAGING】

輸送、保管時に製品に傷がつかないように梱包を行う。

Parts shall be packaged to protect against damage during handling, transit and storage.

【7. 挿入力及び抜去力 INSERTION / WITHDRAWAL FORCE】

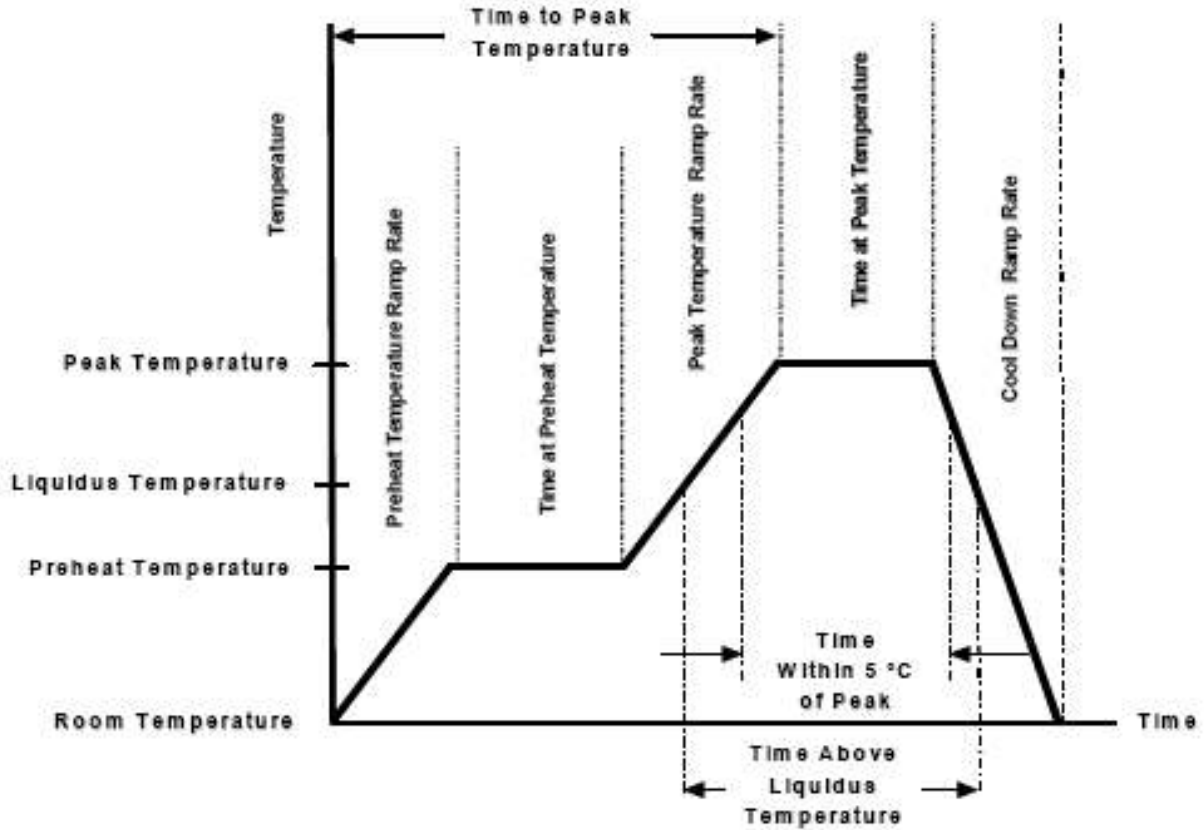
極数 No. of CKT	単位 UNIT	挿入力（最大値） Insertion (MAX.)			抜去力（最小値） Withdrawal (MIN.)		
		初回 1st	3回目 3th	10回目 10th	初回 1st	3回目 3th	10回目 10th
2	N	18	18	18	4.0	1.5	1.2
3	N	21	21	21	4.0	1.5	1.2
4	N	24	24	24	4.0	1.5	1.2
5	N	27	27	27	4.0	1.5	1.2

※ロックを解除して測定 Released lock, and measure.

<b>B</b>	REVISE ON PC ONLY		TITLE: 1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR 製品仕様書  THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
	SEE SHEET 1 OF 16		
	REV.	DESCRIPTION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-78171-010</b>			FILE NAME PS-78171-010.docx
			SHEET 8 OF 16
EN-037(2015-09 rev.4)			



【8. リフロー条件 REFLOW CONDITION】



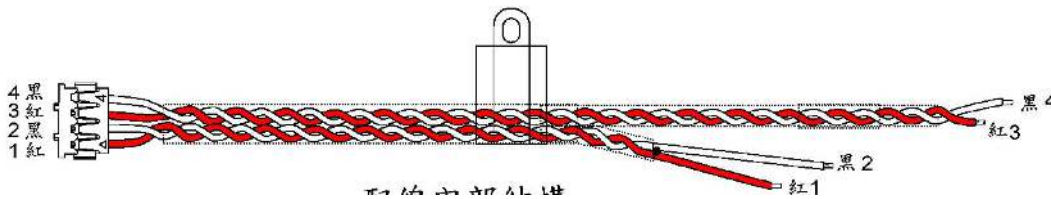
注記：本リフロー条件に関しては、リフロー装置及び基板などにより条件が異なりますので  
 事前に実装評価(リフロー評価)の御確認を御願い致します。  
 端子テール部、ネイル部が変色する場合がございますが、半田付け性には問題ありません。

NOTE : Please check the mount condition (reflow soldering condition) by your own devices  
 beforehand, because the condition changes by the soldering devices, printed circuit boards (PCB), and  
 so on. Although tail of terminal and nail may discolors, a solderability does not have a problem.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR 製品仕様書	
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 16		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-78171-010</b>		FILE NAME PS-78171-010.docx	SHEET 9 OF 16
EN-037(2015-09 rev.4)			

**【9. SET-UP FOR VIBRATION TEST】**

Wires are to be fixed firmly onto the testing jig.



**【10. 注記 NOTES.】**

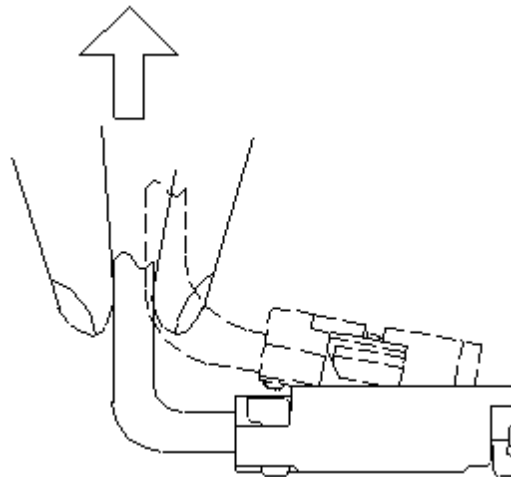
1. コネクタの嵌合を取り外す際は、かならずロックを解除して行ってください。  
When connectors are unmated, positive locks shall be released.
2. 本製品のプラスチック部に黒点、気泡等が確認される場合や色合いが異なる場合（経年変化によるハウジングの変色を含む）が御座いますが、製品性能に影響は御座いません。  
There is no influence in the product performance though the black spot or bubble etc. might be confirmed to the plastic part of this product and the shade might be different (discoloration by secular distortion etc.).
3. 本製品は錫メッキを使用している為、外観に摺動痕がつく場合が御座いますが、製品性能に影響は御座いません。  
The wound of friction might adhere to externals because the tin plating is used for the tail and nail. But there is no influence in the product performance.
4. 本製品のハウジング及びメッキ表面に多少の傷が確認される場合がありますが、製品性能に問題御座いません。  
A few scratches may be confirmed to the surface of the housing and the plating of this product, however, There is no problem in the product performance.
5. 本製品のプラスチック部が紫外線により変色する場合がありますが、製品性能には問題御座いません。  
Discoloration of the plastic part of this product can result from exposure to ultraviolet light. There is no problem in the product performance.
6. 本製品を結露・水濡れが発生する環境でのご使用の場合は、適切な防滴処置をお願い致します。結露・水濡れにより、回路間で絶縁不良を起こす可能性が御座います。  
When this product is used at a place where exposure to water could be expected, please handle with appropriate care to avoid damage from water. There is a possibility of causing insulated malfunction between the circuits.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR 製品仕様書	
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 16		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-78171-010</b>		FILE NAME PS-78171-010.docx	SHEET 10 OF 16
EN-037(2015-09 rev.4)			

7. コネクタの性能を損なう恐れがある為、コネクタの洗浄は、行わないでください。  
Please do not conduct any washing process on the connectors because it may damage the product's function.
8. 本製品をご使用時に取り付けられた電線・プリント基板の共振や、機器の回転構造や可動部分の動作によりコネクタ嵌合部（接点部）が常に動いてしまう状態での御使用は避けてください。  
接触部の摺動磨耗等による 接触不良の原因となります。 従って、機器内で電線・プリント基板を固定し、共振を抑える等の処置をお願い致します。  
Please do not use the connectors in a condition where the wire, PCB, or the contact area is experiencing a sympathetic vibration of wires and PCB, and constant movement of devices.  
This may cause a defect in the contact due to the contact area being worn down. Therefore, please fix wires and PCB on the chassis, and reduces sympathetic vibration.
9. コネクタ嵌合状態で基板の持ち運び等コネクタに負荷が掛かる作業は行わないようにしてください。  
コネクタ破損等の原因となる場合が御座います。  
Please do not do work that the load hangs in the connectors like the carrying of the substrate etc. with the connectors engages. There is a case where it causes the connectors damage etc.
10. 嵌合後、コネクタピッチ方向、スパン方向及び回転方向への負荷がかかるような動作またはセットはしないでください。コネクタ破壊や半田クラックを引き起こします。  
After mated the connectors, please do not allow the PCBs to apply pressure on the connectors in either the pitch direction, the span direction or rotational direction. It may cause damage to the connectors and may crack the soldering.
11. 本製品及び加工工程品（仕掛品）や加工品（ハーネス等）の梱包及び輸送・保管時にはコネクタに負荷が加わらないようご注意ください。変形、破損などの原因となり、コネクタの性能不良の原因となります。  
Please try to prevent any external forces or shock from being applied to the connectors while the cable assembly is in process, when it is being packaged, or while it is in transportation. This may cause deformation and damage to the connectors and cause a defect in the product's performance.
12. 本製品をご使用時には、1PIN当りの定格以上の電流を複数の回路に分岐しての使用は避けてください。  
When using this product, please ensure that the specification for rated current per circuit is followed. Do not allow the sum of the current used on several circuits to exceed the maximum allowable current.
13. 活電状態の電気回路で、挿入、抜去ができることを前提に作られておりません。  
スパーク等による危険の発生、性能不良につながりますので、活電状態での挿入、抜去はしないでください。  
This product is not designed for the mating and unmating of the connectors to be performed under the condition of an active electrical circuit. It may cause a spark and product defect if the connectors are mated and unmated in this way.
14. コネクタに適用できる電線は、原則として錫メッキつき付軟銅撚り線です。  
その他の電線の使用については別途ご確認ください。  
The applicable wire for this connectors, in principle, is tin-plated copper stranded wire. Please consult us and evaluate it in advance when using other wires.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: 1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR 製品仕様書	
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 16		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-78171-010</b>		FILE NAME PS-78171-010.docx	SHEET 11 OF 16
EN-037(2015-09 rev.4)			

- 15. コネクタに外力が加わらないようにクリアランスをあけた筐体構造にしてください。  
Please keep enough clearance between connectors and chassis of your application in order not to apply pressure on the connectors.
- 16. 電線の結束はコネクタから10mm以上のところで、電線に加わる力が均一になるようにしてください。ハーネス品で電線一本（又は特定の数本）に力が加わらない様にしてください。  
Please tie the cable at least 10mm away from the edge of the connectors and try to ensure that the force is applied evenly on all of the wires.
- 17. 治具等を使用して圧着端子を抜いた場合には、ランスが変形し強度が低下し端子を再装着後の端子保持力が極端に低下します。そのため、圧着端子のリペアの際には新しいハウジングを必ず使用してください。  
When extracting a crimp terminal from the housing using a jig, it may deform the housing lance and therefore reduce the terminal retention force enormously after re-inserting of the terminal. Therefore, please ensure to use a new housing after repairing the crimp terminals.
- 18. ハーネス加工品及びコネクタ嵌合後の電線の引き回しの際、引張りによる力が加わりますと、接点部、結線部（圧着部）やロック部（端子ロック部）が損傷を受け、接触不良の原因となります。電線の引回し配線をされる場合、コネクタに無理な外力が加わらないように、電線に緩みを持たせ、余裕を持たせる処置をしてください。  
The cable assembly should not have a constant stress or pulling force applied on it when it is in the mated condition. This phenomenon may damage the contact area or wiring area (crimping). Therefore, when designing the wire positioning, please ensure that there is enough length of wire to avoid stress on the connectors.
- 19. 電線はまとめて軽くつかみ、ゆっくり、垂直方向にまっすぐに引き抜いてください。また、斜めにこじりながら抜くことは避けてください。コネクタを破損させる恐れが御座います。  
Please hold wires all together lightly. And please withdraw receptacle housing slowly, axially and vertically. Please avoid withdrawing them with an angle and roughly. That might cause damage to connector.



REVISE ON PC ONLY		TITLE: 1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR 製品仕様書	
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 16		
REV.	DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-78171-010</b>		FILE NAME PS-78171-010.docx	SHEET 12 OF 16
EN-037(2015-09 rev.4)			

- 20. 圧着高さ、状態、適用電線等の詳細は、弊社圧着仕様書：CS-78172-012, CS-78172-013を参照願います。  
The details refer to CS-78172-012, CS-78172-013 such as crimping satisfied height, state & applicable wire.
- 21. 嵌合後、コネクタピッチ方向、スパン方向及び回転方向への負荷がかかるような動作またはセットはしないでください。コネクタ破壊やはんだクラックを引き起こします。  
After mating, please do not take a connector pitch direction, a span direction and load to the rotator direction. It causes connector destruction and the solder crack.
- 22. ハウジングのロック部やランス部などの可動部、及び端子を故意に変形させないでください。製品性能が満足出来ない原因となります。  
Do not deform the movable part as lock part and lance part of Plug, HS'G and terminals on purpose. It would lead to product failure.
- 23. 半田実装部の未半田は、ターミナル脱落、ピン間ショート、ターミナル座屈、またコネクタ基板からの外れが懸念されます。従って全てのターミナルテール部及び、ネイル部に半田付けを行ってください。  
If you leave any soldering area on this product open, there may be the possibility of a missing terminal short circuiting between pins, terminal buckling or the potential for the connectors to come off of the PCB. Therefore, please solder all of the terminals and fitting nails on the PCB.
- 24. 実装機によってコネクタに負荷が加わると変形、破損する場合がありますので事前にご確認ください。  
If there is accidental contact with the connectors while it is going through the reflow machine, there may be deformation or damage caused to the connectors. Please check to prevent this.
- 25. 実装性能（平坦度）は、実装基板の反りの影響を含まないものと致します。基板の反りはコネクタ両端部を基準とし、コネクタ中央部にて Max0.02mmとしてください。  
The mounting specification for coplanarity does not include the influence of warpage of the PCB. The warpage of the PCB should be a maximum of 0.02mm if measuring from one connectors edge to the other.
- 26. 梱包品の推奨保管条件を超えた場合は外観、半田付け性を確認の上ご使用ください。  
Please use it after confirming externals and soldering when the storage condition of packing goods is over recommended storage condition.
- 27. 基板実装前後に端子及びネイルに触らないでください。  
Please do not touch the terminals and fitting nails before or after mounted the connectors onto the PCB.
- 28. 基板実装後に基板を直接積み重ねない様に注意してください。  
Please do not stack the PCB directly after mounted the connectors on it.
- 29. 実装後において手半田コテによるリペアを行なう際は、必ず仕様書掲載の条件以内で行なってください。条件を超えて実施した場合、端子の抜け、接点ギャップの変化、モールドの変形、溶融等が原因により破損の原因になります。  
Please conduct it under the condition of the specifications when repairing by hand soldering iron after mounting. In the case of practicing beyond the condition, the backlash, the change in the contact gap, the deformation of the mold and the melting, etc. may cause damage.

REVISE ON PC ONLY		TITLE: <b>1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR</b> 製品仕様書
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 16	
THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION		
REV.	DESCRIPTION	
DOCUMENT NUMBER <b>PS-78171-010</b>		FILE NAME PS-78171-010.docx
		SHEET 13 OF 16
EN-037(2015-09 rev.4)		



- 30. 半田コテによる手修正を行なう際、過度の半田やフラックスを使用しないでください。半田上がりやフラックス上がりにより接触、機能不良に至る場合が御座います。  
When conducting manual repairs using a soldering iron, please do not use more solder and flux than needed. This may cause solder wicking and flux wicking issues, and it will eventually cause a contact defect and functional issues.
- 31. コネクタのみで基板を支えることは避け、コネクタ以外での基板固定対策を行ってください。  
Please do not use the connectors alone to provide mechanical support for the PCB. Please ensure that there is a fixed structure on the phone chassis or other component support for the PCB.
- 32. 本製品の平坦度については、実装前での保証のみであり、実装中および実装後での平坦度については、保証の限りではありません。  
Coplanarity is assured only before mounting. There is no guarantee of coplanarity after mounting and in the reflow.
- 33. 弊社の推奨基板パターン寸法を変更して設計を行なう際は、致命的な不良の原因にもなりますのであらかじめご相談ください。  
In the case of changing our recommended board pattern size and designing, please consult in advance because it may cause a fatal defect.
- 34. 本品の一般性能確認はガラスエポキシ基板にて実施していますので、フレキシブル基板等の特殊な基板へ実装してご使用の際は、別途ご相談願います。  
It is necessary to consult separately when mount product on a special PCB or FPC.
- 35. 嵌合は極力嵌合軸に沿って平行に行ってください。その際、リセハウジングとプラグの外壁同士を合せる様に位置決めした後に押し込み、コネクタ同士が突き当たる（完全嵌合位置）まで真っ直ぐ押し込んでください。斜めの嵌合になる場合は10°以下の角度でリセハウジングとプラグの外壁同士を軽く当て、位置決めした後に嵌合してください。尚、コネクタ同士を過度に傾けた状態で嵌合を行いますと、ハウジングが破壊する恐れがありますのでこのような嵌合はお避けください。  
Please do the mating as much as possible to along to mating axis. At this time, positioning each side of external faces of receptacle housing and plug and push to mating until both connectors strikes each other (complete mating position). In the case of diagonal mating, touch with external faces with receptacle housing and plug under the angle of 10°lightly, and push to mating in order to avoid the connector break.
- 36. リフロー条件によっては端子メッキ部にヨリ等が発生する場合がありますが、製品性能には影響ありません。  
There is no influence in the product performance though the twist might be generated in the terminal plating part according to the reflow condition.
- 37. リフロー条件によっては樹脂部に変色が発生する場合がありますが、製品性能には影響ありません。  
There is no influence in the product performance though discoloration might be generated in the resin according to the reflow condition.
- 38. リフロー後、半田付け部に変色が見られることがありますが、製品性能に影響はありません。  
Although there might be some discoloration seen on the soldering tail after reflow, this will not influence the product's performance.

REVISE ON PC ONLY		TITLE:  1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR 製品仕様書	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION	
<b>B</b>	SEE SHEET 1 OF 16			
REV.	DESCRIPTION			
DOCUMENT NUMBER <b>PS-78171-010</b>		FILE NAME PS-78171-010.docx	SHEET 14 OF 16	
EN-037(2015-09 rev.4)				

39. 本製品は大気リフローでの実装を想定しています。N2リフローで実装した場合、リフロー後、半田上がりを生じる恐れがあります。N2リフローでの実装をお考えの場合、別途評価が必要になります。  
Please investigate the mounting condition (reflow soldering condition) on your own devices beforehand. The mounting conditions may change due to the soldering temperature, soldering paste, air reflow machine, Nitrogen reflow machine, and the type of PCB. The different mounting conditions may have an influence on the product's performance.
40. 弊社評価では厚さ0.1mm、開口率100%のメタルマスクを使用しています。  
Thickness 0.1mm, aperture ratio 100% metal mask is used in this specification.

<b>B</b>	REVISE ON PC ONLY	SEE SHEET 1 OF 16	TITLE: 1.20mm PITCH, W-T-B CONNECTOR 製品仕様書	
	REV.		DESCRIPTION	THIS DOCUMENT CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INC. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
DOCUMENT NUMBER <b>PS-78171-010</b>			FILE NAME PS-78171-010.docx	SHEET 15 OF 16
EN-037(2015-09 rev.4)				

